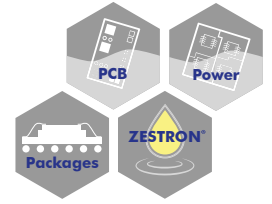


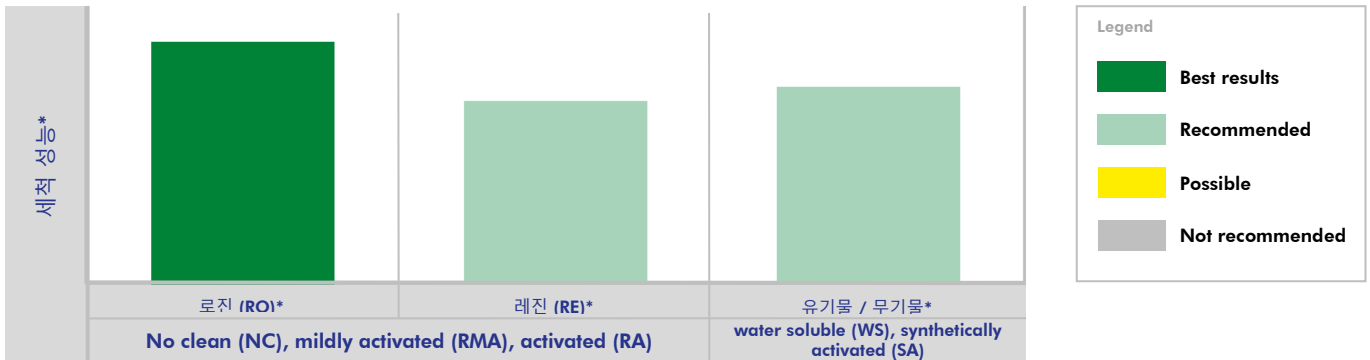
## ZESTRON® FA+



디플럭싱(defluxing) 공정에 사용되는 준수계 기반의 솔벤트 용액

ZESTRON® FA+는 전자어셈블리, 세라믹 하이브리드, 전력 반도체(파워 모듈, 리드프레임, 파워 LED) 및 전자 패키지(플립칩/CMOS)에 있는 플럭스 잔사를 제거하기 위해 개발된 솔벤트계 세척 용액입니다. 이 제품은 뛰어난 세척성과 높은 bath 로딩 용량으로 긴 세척 수명이 보장되는 것이 특징입니다.

### 적용 범위 – PCBA, 전력반도체 및 패키지 디플럭싱(Defluxing)



\* J-STD-004

### 다른 세척제와 비교 시 이점

- ZESTRON® FA+는 특별한 방폭 장치가 요구되지 않습니다.
- 높은 bath 로딩 용량으로 bath 수명이 연장됩니다.
- 계면활성제 성분이 없기 때문에 쉽게 린스가 가능합니다.
- 전력 모듈, 리드프레임 기반 부품, 파워 LED 의 와이어 본딩 및 몰딩 과정에서 품질이 향상됩니다.
- 플립칩과 CMOS 위에 점성이 있는 모든 플럭스를 제거하여 보이드(void)가 없는 언더필을 제공하고, 이미지 해상도를 개선합니다.
- ZESTRON® FA+는 ESA '신고 대상 목록'에 등록되어 있습니다.

### 공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 헹굼	3. 건조
딤 탱크 (Ultrasonic)	PCBA, 하이브리드, 파워 모듈, 리드프레임, 파워 LED, 플립칩, CMOS	ZESTRON® FA+	DI-water	Hot air
딤 탱크 (Spray-under-immersion)	PCBA, 하이브리드	ZESTRON® FA+	DI-water	Hot air
원심 분리 세척	PCBA, 하이브리드	ZESTRON® FA+	DI-water	Hot air